



新闻动态

- ▶ 图片新闻
- ▶ 头条新闻
- ▶ 综合新闻
- ▶ 学术活动
- ▶ 科研动态
- ▶ 通知公告
- ▶ 业内信息
- ▶ 合作交流

现在位置: 首页 > 新闻动态 > 科研动态

02专项“高密度三维系统级封装的关键技术研究”项目启动

2009-09-10 | 编辑: | 【大】 【中】 【小】 【打印】 【关闭】

2009年8月31日—9月2日, 02重大专项“高密度三维系统级封装的关键技术研究”项目启动暨技术研讨会在微电子所召开。微电子所所长、02专项专家组组长叶甜春到会并发表讲话, 项目组相关领导、专家以及合作单位代表40余人参加了会议

“高密度三维系统级封装的关键技术研究”项目由中科院微电子所为牵头组织单位, 微电子所系统封装技术研究室(九室)主任万里兮研究员任项目组长。项目组联合单位包括清华大学、北京大学、复旦大学、华中科技大学、中南大学、中科院上海微系统所和深圳先进技术研究院。合作企业包括深南电路有限公司、南通富士通微电子股份有限公司、江苏长电科技股份有限公司、江阴长电先进封装有限公司、深圳丹邦科技股份有限公司。

与会人员在会上进行了交流和讨论, 02专项专家组组长叶甜春指出, 02专项的任务和目标是提升我国封装领域的技术水平, 研究内容要围绕未来3到5年封装企业所需要的技术展开, 研究成果要为后续的产业化提供良好的基础。长电科技副董事长、02专项责任专家于燮康认为, 目前国内的封装企业与科研院所合作的愿望非常强烈, 该项目“产学研用”的合作方式很好地顺应了市场需求。

会上, 企业代表深南电路副总工程师孔令文、南通富士通技术总监吴晓纯、长电科技副总经理李维平、长电先进封装总经理赖志明围绕企业的技术需求、发展路线分别作了报告, 为今后的技术合作、研究成果转移指明了方向。此外, Intel公司资深研究员卢基存博士、香港应用科技研究院有限公司史训清博士分别作了“系统封装技术研究及产业化简介”、“三维集成技术: 挑战和策略”特约报告, 对系统级封装的研究现状、技术挑战、关键技术等进行了详细分析。

研讨会上, 项目联合单位负责人与企业代表还进行了热烈的讨论, 进一步细化了项目的研究内容、考核指标、时间节点等问题。最后, 会议讨论通过并签署了02重大专项项目管理办法。项目启动会的成功召开为专项的顺利开展开了好头。



研讨会现场



附件下载:

相关新闻:

龙芯CPU第一款国产化产品在微电子所取得封装成功
微电子所在高端芯片国产化封装技术上取得重大突破
微电子所“新型微电子器件及其集成封装的前瞻性研究”创新团队合作计划获得论证通过

\



中国科学院微电子研究所版权所有 邮编：100029
单位地址：北京市朝阳区北土城西路3号，电子邮件：webadmin@ime.ac.cn
京公网安备110402500036号